

Oven for the soldering or sticking without flux of semiconducting microchips.

Patent Number: EP0411596
Publication date: 1991-02-06
Inventor(s): HUGGARD ERICH DIPL-PHYS (DE); ALTHAUS HANS-LUDWIG DR DIPL-PH (DE); BOGNER GEORG DIPL-PHYS (DE)
Applicant(s): SIEMENS AG (DE)
Requested Patent: ☐ EP0411596, A3, B1
Application Number: EP19900114731 19900731
Priority Number(s): DE19893925340 19890731
IPC Classification: B23K1/008; B23K3/047
EC Classification: B23K1/008, H01L21/00S2T, F27B17/00B1
Equivalents:

Abstract

An oven for soldering or gluing semiconductor microchips (4) to support substrates (5) or contact pieces without flux, which has an oven chamber (2) having a device (8) for flushing with protective gas and an electrically controlled heating device, is to be quick-responding and readily controllable with low heating power. As heating device, at least one semiconductor chip (1) is arranged inside the oven chamber and has at least one electrically locally heatable region, and at least one of the parts (4, 5) to be joined is brought into direct thermal contact with the semiconductor chip (1) by an attaching device (3) during the soldering or gluing. An oven according to the invention is used, in particular, for soldering semiconductor lasers and semiconductor diodes without flux.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 411 596 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90114731.4

(51) Int. Cl.⁵: **B23K 3/047**

(22) Anmeldetag: 31.07.90

(30) Priorität: 31.07.89 DE 3925340

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.02.91 Patentblatt 91/06

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

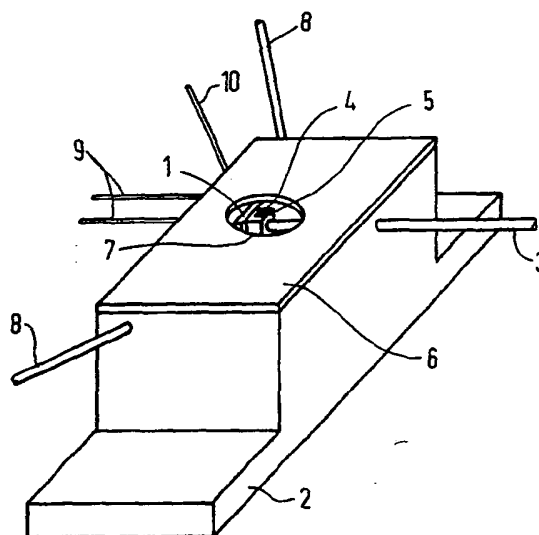
(71) Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft**
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

(72) Erfinder: **Bogner, Georg, Dipl.-Phys.**
Eberhard-Faber-Strasse 58
D-8430 Neumarkt(DE)
Erfinder: **Hufgard, Erich, Dipl.-Phys.**
Dechbettenerstrasse 32
D-8400 Regensburg(DE)
Erfinder: **Althaus, Hans-Ludwig, Dr.**
Dipl.-Phys.
Heinrich-Heine-Strasse 11
D-8417 Lappersdorf(DE)

(54) **Ofen zum flussmittelfreien Löten oder Kleben von Halbleitermikrochips.**

(57) Ein Ofen zum flußmittelfreien Löten oder Kleben von Halbleiter-Mikrochips (4) auf Trägersubstrate (5) oder Kontaktteile, mit einer Ofenkammer (2), die eine Einrichtung (8) zum Spülen mit Schutzgas und eine elektrisch gesteuerte Heizeinrichtung aufweist, soll bei geringer Heizleistung sehr reaktionsschnell und gut steuerbar sein. Als Heizeinrichtung ist mindestens ein Halbleiterchip (1) innerhalb der Ofenkammer angeordnet, der mindestens einen elektrisch lokal erhitzbaren Bereich aufweist, und zumindest eines der zu verbindenden Teile (4, 5) ist während des Lötens oder Klebens durch eine Befestigungseinrichtung (3) mit dem Halbleiterchip (1) in direkten thermischen Kontakt gebracht.

Ein erfindungsgemäßer Ofen findet insbesondere zum Löten von Halbleiter-Lasern und -Dioden ohne Flußmittel Anwendung.



EP 0 411 596 A2

OFEN ZUM FLUSSMITTELFREIEN LÖTEN ODER KLEBEN VON HALBLEITER-MIKROCHIPS.

Die Erfindung betrifft einen Ofen zum flußmittelfreien Löten oder Kleben von Halbleiter-Mikrochips auf Trägersubstrate oder Kontakteile, mit einer Ofenkammer, die eine Einrichtung zum Spülen mit Schutzgas und eine elektrisch gesteuerte Heizeinrichtung aufweist.

Derartige Öfen sind bekannt und werden beispielsweise in der Metall-, Keramik-, Glas- und Kunststoffindustrie für alle Arten der Wärmebehandlung verwendet. Je nach Art der Beheizung unterscheidet man zwischen elektrischen Öfen und solchen, die mit Gas oder Kohle beheizt werden. Bei den in Betracht zu ziehenden elektrischen Öfen wird wiederum zwischen Widerstandsöfen, Lichtbogenöfen und Induktionsöfen unterschieden, und zwar je nach der physikalischen Grundlage der Umwandlung der elektrischen in Wärmeenergie. Das Kammervolumen der Öfen liegt dabei zwischen wenigen Kubikzentimetern für Forschungs- und Laboratoriumszwecke bis hin zu einer Größenordnung von Kubikmetern bei technischen Öfen.

Zum flußmittelfreien Löten bzw. Kleben von Halbleiter-Mikrochips auf Wärmesenken bzw. Trägersubstrate wurden bisher derartige herkömmliche Ofensysteme verwendet. Die Wärmebehandlung erfolgt dabei durch mittelbare bzw. indirekte Erwärmung über Heizleiter in bzw. an der Ofenkammerwand. Die Ofenkammer muß während des Lötprozesses evakuiert und anschließend mit H_2 -Gas gefüllt werden. Eine derartige Anlage ist in ihrer Funktionsweise relativ träge und aufwendig. Zum Löten bzw. Kleben von Mikrochips ebenfalls verwendbare Heizfolien sind zwar reaktionsschneller als die herkömmlichen Ofensysteme, allerdings neigen diese Folien beim Aufheizen zur Welligkeit. Die daraus resultierende Unebenheit der Auflagefläche ist bei der Winzigkeit der zu verbindenden Bauteile besonders störend.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu vermeiden und einen Ofen zum flußmittelfreien Löten oder Kleben von Mikrochips zu schaffen, der bei geringer Heizleistung sehr reaktionsschnell und gut steuerbar ist.

Diese Aufgabe wird bei einem Ofen der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß als Heizeinrichtung mindestens ein Halbleiterchip innerhalb der Ofenkammer angeordnet ist, der mindestens einen elektrisch lokal erheizbaren Bereich aufweist, und daß zumindest eines der zu verbindenden Teile während des Lötens oder Klebens durch eine Befestigungseinrichtung mit dem Halbleiterchip in direkten thermischen Kontakt gebracht ist.

Der vorzugsweise aus Silizium oder Siliziumkarbid bestehende Halbleiterchip weist dabei als

lokal erheizbaren Bereich einen ohmschen Widerstand, einen Schottky-Kontakt, d.h. einen Metall-Halbleiterkontakt, oder einen pn-Übergang auf.

Die Ofenkammer besteht beispielsweise aus einem Metall. Vorzugsweise ist die Ofenkammer aus einem Gehäuse gebildet, das mit einer Quarzabdeckung versehen ist, die zweckmäßig eine Öffnung aufweist. Die Öffnung ist verschließbar und dient zur Beschickung des Ofens. Die Quarzabdeckung dient als Sichthilfe.

Insbesondere dann, wenn das Gehäuse der Ofenkammer aus Metall besteht und der als Heizeinrichtung dienende Halbleiterchip an einer Wand der Ofenkammer befestigt ist, ist es zweckmäßig, den Halbleiterchip gegen die Gehäuse- bzw. Ofenwand thermisch zu isolieren. Als thermischer Isolator kann beispielsweise Quarzglas verwendet werden.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß das Halbleitersubstrat des bzw. der als Wärmequelle verwendeten Mikrochips gegenüber herkömmlichen Heizsystemen aus Metall im wesentlichen folgende Vorteile bietet:

- a) höherer elektrischer Widerstand, dadurch Verringerung des Leitungsquerschnittes der elektrischen Zuleitungen,
- b) geringere Masse, dadurch geringere Verlustleistung und höhere Dynamik,
- c) durch unterschiedliche Dotierung in weitem Bereich einstellbarer elektrischer Widerstand des Halbleitermaterials, dadurch Verbesserung der Ansteuermöglichkeit.

Anhand eines in der Figur der Zeichnung rein schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels wird die Erfindung näher erläutert.

Bei dem in der Figur dargestellten Ofen werden zum Aufheizen der zu klebenden oder zu lötenden Teile ohmscher Widerstand bzw. Schottkykontakt oder pn-Übergang von Halbleiterchips 1 vorzugsweise aus Silizium oder Siliziumkarbid geeigneter Größe ausgenutzt, die als Wärmequelle dienen. Der Halbleiterchip 1 befindet sich elektrisch kontaktiert und thermisch isoliert in einer Ofenkammer 2 z.B. aus Metall, beispielsweise Aluminium. Diese Ofenkammer 2 wird beim flußmittelfreien Löten mit Formiergas bzw. einem anderen Trägergas gespült und ist durch einen Deckel 6, z.B. aus Quarzglas, in dem sich eine Öffnung 7 befindet, abgedeckt. Durch diese Öffnung 7 können Träger- oder Kontakteile 5 bzw. die zu lötenden Mikrochips 4 auf den als Wärmequelle vorgesehenen Halbleiterchip 1 zugeführt und festgehalten werden. In diesem Beispiel ist auf einem als Heizeinrichtung bzw. Wärmequelle dienenden Siliziumchip 1 ein zu lötender Mikrochip 4 auf einer Wärmesenke

bzw. einem Trägersubstrat 5 angeordnet und das Trägersubstrat 5 mittels eines Bolzens 3 als Befestigungseinrichtung an der Siliziumwärmequelle 1 befestigt. Damit ist das Trägersubstrat 5 als mit dem Mikrochip 4 zu verbindendes Teil mit dem Halbleiterchip 1 in direkten thermischen Kontakt gebracht. Nach Einschalten des Stromes, der über die elektrischen Anschlüsse 9 dem Halbleiterchip 1 zugeführt wird, heizt sich der als Wärmequelle vorgesehene Halbleiterchip 1 je nach Regelprogramm auf und gibt die Wärme an die zu verlötenden oder zu verklebenden Bauteile ab.

Grundtemperatur, Aufheizgeschwindigkeit und Heizprofile können durch das (nicht dargestellte) Netzgerät vorgegeben werden. Die Temperaturüberwachung erfolgt zweckmäßig über ein im Inneren des Gehäuses 2 angeordnetes Thermoelement, dessen nach außen führende Verbindung in der Figur mit dem Bezugszeichen 10 versehen ist.

Eine homogene Schutzgasspülung, die über die Zu- bzw. Abführungen 8 erfolgt, verhindert beim Löten das Oxidieren der Lotoberfläche und macht Flußmittel überflüssig.

Insbesondere durch die geringe Masse der Wärmequelle, d.h. des Halbleiterchips, ist ein erfindungsgemäßer Mikroofen gegenüber herkömmlichen Öfen sehr reaktionsschnell und gut steuerbar. Die erforderliche Heizleistung ist auch bei sehr schnellem Hochheizen, beispielsweise in 0,5s auf 300 °C, sehr gering.

Widerstand, einen Schottky-Kontakt oder einen pn-Übergang aufweist.

5. Ofen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Halbleiterchip (1) aus Silizium oder aus Siliziumkarbid besteht.

6. Ofen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß der als Heizeinrichtung dienende Halbleiterchip (1) an einer Wand der Ofenkammer (2) gegen diese thermisch isoliert befestigt ist.

Ansprüche

1. Ofen zum flußmittelfreien Löten oder Kleben von Halbleiter-Mikrochips auf Trägersubstrate oder Kontaktteile, mit einer Ofenkammer, die eine Einrichtung zum Spülen mit Schutzgas und eine elektrisch gesteuerte Heizeinrichtung aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Heizeinrichtung mindestens ein Halbleiterchip (1) innerhalb der Ofenkammer (2) angeordnet ist, der mindestens einen elektrisch lokal erhitzbaren Bereich aufweist, und daß zumindest eines der zu verbindenden Teile (4, 5) während des Lötens oder Klebens durch eine Befestigungseinrichtung (3) mit dem Halbleiterchip (1) in direkten thermischen Kontakt gebracht ist.

2. Ofen nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Ofenkammer (2) aus einem Gehäuse besteht, das mit einer Quarzglasabdeckung (6) versehen ist, die eine Öffnung (7) aufweist.

3. Ofen nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Befestigungseinrichtung (3) ein Befestigungsbolzen ist.

4. Ofen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Halbleiterchip (1) als lokal erhitzbaren Bereich einen ohmschen

5

10

15

20

25

30

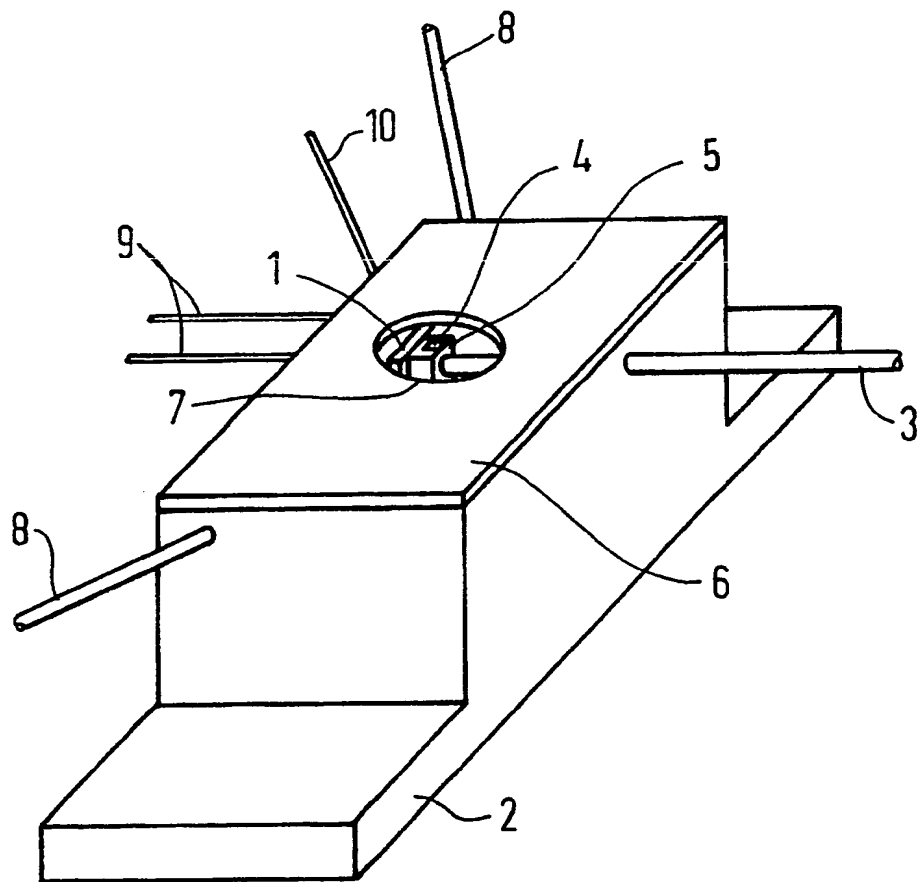
35

40

45

50

55



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 411 596 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **90114731.4**

(51) Int. Cl.⁵: **B23K 3/047**

(22) Anmeldetag: **31.07.90**

(30) Priorität: **31.07.89 DE 3925340**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.02.91 Patentblatt 91/06

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(98) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **22.05.91 Patentblatt 91/21**

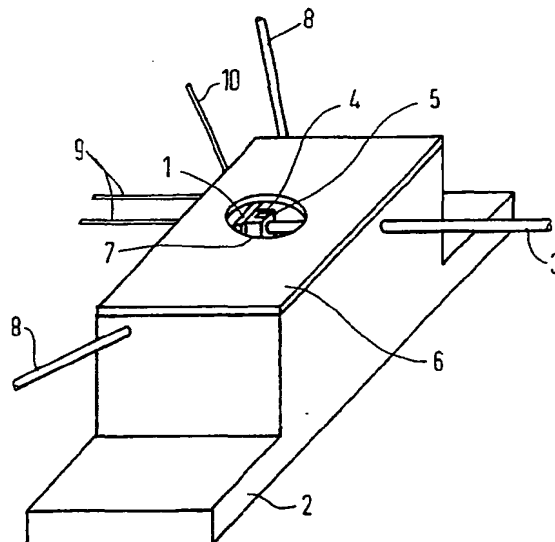
(71) Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft**
Wittelsbacherplatz 2
W-8000 München 2(DE)

(72) Erfinder: **Bogner, Georg, Dipl.-Phys.**
Eberhard-Faber-Strasse 58
W-8430 Neumarkt(DE)
Erfinder: **Hufgard, Erich, Dipl.-Phys.**
Dechbettenerstrasse 32
W-8400 Regensburg(DE)
Erfinder: **Althaus, Hans-Ludwig, Dr.**
Dipl.-Phys.
Heinrich-Heine-Strasse 11
W-8417 Lappersdorf(DE)

(54) **Ofen zum flussmittelfreien Löten oder Kleben von Halbleitermikrochips.**

(57) Ein Ofen zum flußmittelfreien Löten oder Kleben von Halbleiter-Mikrochips (4) auf Trägersubstrate (5) oder Kontaktteile, mit einer Ofenkammer (2), die eine Einrichtung (8) zum Spülen mit Schutzgas und eine elektrisch gesteuerte Heizeinrichtung aufweist, soll bei geringer Heizleistung sehr reaktionsschnell und gut steuerbar sein. Als Heizeinrichtung ist mindestens ein Halbleiterchip (1) innerhalb der Ofenkammer angeordnet, der mindestens einen elektrisch lokal erhitzbaren Bereich aufweist, und zumindest eines der zu verbindenden Teile (4, 5) ist während des Lötens oder Klebens durch eine Befestigungseinrichtung (3) mit dem Halbleiterchip (1) in direkten thermischen Kontakt gebracht.

Ein erfindungsgemäßer Ofen findet insbesondere zum Löten von Halbleiter-Lasern und -Dioden ohne Flußmittel Anwendung.



EP 0 411 596 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 4731

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. C1.5) |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 118 (M-475)(2175) 02 Mai 1986, & JP-A-60 247467 (TOSHIBA) 07 Dezember 1985, * das ganze Dokument * | 1,2 | B 23 K 3/047 B 23 K 1/008 |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 244 (M-834)(3592) 07 Juni 1989, & JP-A-01 53763 (KOMATSU) 01 März 1989, * das ganze Dokument * | 1,3,4 | |
| A | IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, HYBRIDS, AND MANUFACTURING vol. 11, no. 4, Dezember 1988, NEW YORK US Seiten 447 - 451; MIZUSHI et al.: "Fluxless and Virtually Voidless Soldering for Semiconductor Chips" * Seite 447, linke Spalte, Absatz 1 - Seite 451, rechte Spalte, letzter Absatz; Figuren 1, 3 * | 1,2,4,5 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. C1.5) |
| | | | B 23 K |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort | | Abschlußdatum der Recherche | Prüfer |
| Den Haag | | 21 März 91 | HERBRETEAU D.J-P.J. |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | | | |